



CATEGORY 01

高機能金屬

日本鏡鈹

NIPPON KYOBAN・大阪府 寝屋川市

PRODUCT LINE・主產品線

電路板專用層壓鈹

PCB Mirror Steel Plate・CCL / PCB Press Plate

SPECIFICATIONS・規格

項目・ITEM	數值・VALUE	備註・REMARK
主要牌號 Grade	SUS630・SUS301-3/4	兩款 PCB 用
熱傳導係數 Thermal Conduct.	13.7・16.3	SUS630 / SUS301
線膨脹率 Expansion	10.8・16.9	SUS630 / SUS301
硬度 Hardness	≥450HV・≥370HV	SUS630 / SUS301
厚度範圍 Thickness	0.6 - 2.0 mm	0.6 / 0.8 / 1.2 / 1.5 / 2.0
表面粗糙度 RA	0.05 - 0.07 μm	高光鏡面
表面粗糙度 RZ	0.55 - 0.9 μm	—
平行度 / 對角差	≤ 0.05 mm / ≤ 2 mm	50 μm 公差

APPLICATION・應用領域

PCB 製造

層壓壓合製程

半導體 / 載板

高密度互連層

FPC 多層板

精密 lamination

PROCESS CAPABILITIES・加工特性

鏡面拋光・可磁化	高光表面結構設計、抗靜電處理
去毛邊・圓角加工	邊緣 R3~R5, 無針孔砂眼
壓合後彎翹規格	銅板 ≤800mm: ≤3mm / 銅板 ≥800mm: ≤5mm
表面標記	表面鋼印・定位孔・QR碼・序列號・Data Matrix
尺寸公差	銅板尺寸 +2/-0 mm・銅板厚度 -0.05/+0.1 mm

合作夥伴

日本鏡鈹株式会社